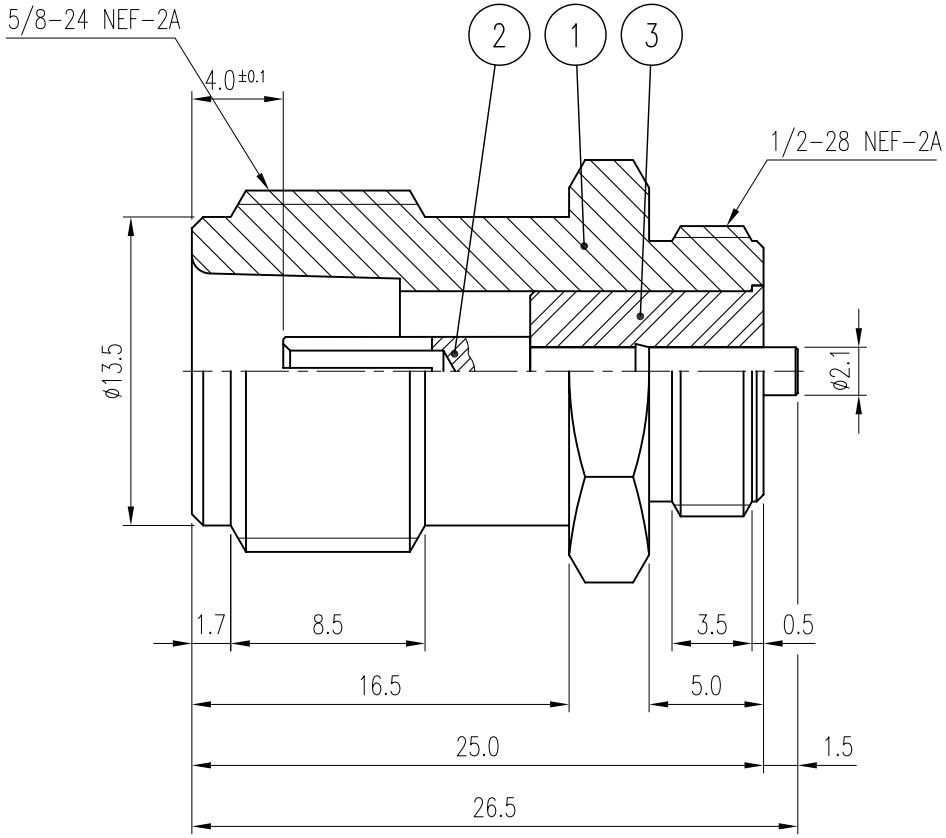
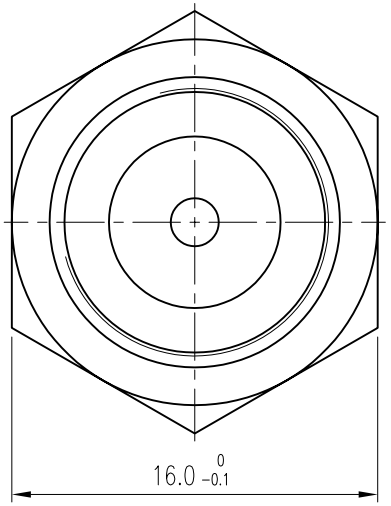
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	원가 절감[설변No.연구2006-209] (도금 두께 변경)	김은희	윤상진	2006. 10. 24.





	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00683-N/1 (H8106)
1	2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate ~~Silver Plate(6μm)~~	DCT00720-5/1 (E8304)
1	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate(유광) ~~Nickel Plate(무전해)~~	DBD00955-5/1 (D8317)

대체가능재질

공통공차

소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2005. 1. 3.
승인	
검도	
제도	
검도	
작성부서	연 구 소
척도 NS	단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N-J-BR VER.1

A4

도번 CN00801-7/1

K345-540-000